

第47回ソルダリング分科会プログラム

日時:平成21年 7月 3日(金) 10:30~16:30

場所:自動車会館 大会議室(東京都千代田区)

主 題 「はんだ接合信頼性の最新動向」

時 間	題 目	講 演 者
10:30~ 12:00	司会 気賀智也(ソニーイーエムシーエス(株))(予定)	
	『車載実装の鉛フリー化と高信頼性』 (45分)	千住金属工業(株) ○上島稔、豊田良孝
	『高い接合信頼性を実現した 熱硬化性はんだ接合剤』 (45分)	タムラ化研(株) ○柿田俊彦、中林孝氏、田代敏哉
12:00~ 13:00	昼 食 休 憩	
13:00~ 13:10	分 科 会 議 事	
13:10~ 14:40	司会 西川 宏(大阪大学)(予定)	
	『放射光 X 線 CT によるフリップチップはんだ 接合部における熱疲労き裂の3次元観察』 (45分)	富山県工業技術センター ○釣谷浩之、佐山利彦 コーセル(株) 岡本佳之、高柳 毅 (財)高輝度光科学研究センター 上杉健太郎 富山県立大学 森 孝男
	『はんだ凝固形状の予測シミュレーションと 疲労寿命評価への適用』 (45分)	FDK(株) ○山中哲、袴田和喜 (株)富士通研究所 作山誠樹、清水浩三
14:40~ 15:00	休 憩	
15:00~ 16:30	司会 武井利泰(日本精工(株))(予定)	
	『無電解金めっきプロセスにおける はんだ接合信頼性の向上』 (45分)	奥野製薬工業(株) ○田邊 靖博
	『高加速冷熱衝撃装置(HAATS) 加速性の検証結果』 (45分)	エスペック(株) ○田中秀樹、大成隆章 由利雅明、辻江一作、前川裕行

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。